

Die F & K Delvotec Bondtechnik GmbH wird zusätzlich zum eigenen Stand in Halle 7 auf der vom IZM organisierten Produktionslinie in Halle 6 vertreten sein.

-dir/gk-

F & K Delvotec Bondtechnik GmbH, Daimlerstraße 5-7,
D-85521 Ottofurn, www.fkdelvotec.com

Halle 7, Stand 416 und Halle 6, Stand 434

Fineplacer[®] matrix von Finetech

In der Reworkkonfiguration Fineplacer[®] matrix rs ist das System als innovative Heißgasreparaturplattform ideal gerüstet für eine große Bandbreite unterschiedlicher Reparaturanwendungen. Das integrierte Prozessmanagement (IPM) und die Entwicklung unter Einbeziehung führender OEM machen das System zur Referenz im Bereich des professionellen Reworks.

Aushängeschild des Fineplacer[®] matrix rs ist das besonders energieeffiziente Unterheizmodul RB30, das Maßstäbe in der Reparatur großer Multilayer-Boards setzt. Durch die perfekte Abstimmung mit der Ober-

heizung garantieren 4200 W Leistung eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung auf großen Boards und Bauteilen mit hoher Wärmeaufnahme. Zwölf separat im Heizprofil anwählbare Heizsegmente ermöglichen einen gezielten, lokal begrenzten Wärmeeintrag in ein oder gleich mehrere Leiterplatten. Somit können mehrere Platinen in kurzer Zeit nachgearbeitet werden, durch die verkürzten Prozesszeiten wird der Workflow optimiert. Optional reduziert zudem eine integrierte Forced Cooling Funktion die Abkühlphasen zwischen den Prozessen um bis zu zwei Drittel.

Dank hoher Standzeiten, schneller Umrüstung sowie einfachen Service-Zugriffs ist der Fineplacer[®] matrix rs die ideale Wahl für die 24/7 SMD Reparatur in Produktionsumgebungen.

Für anspruchsvolle Montageanwendungen ist das System auch als Bonder mit bis zu 3 µm Platziergenauigkeit verfügbar. Die hohe Genauigkeit über die Gesamtfläche auch großer Substrate wie beispielsweise 12-Zoll-Wafer, der großzügige Arbeitsabstand, hilfreiche Detaillösungen wie die Y-Toolverschiebung, das HD-Prozessvideomodul oder das vollständig prozessintegrierte CleverDispense-System, automatisierte Prozesse sowie natürlich die fast unerschöpfliche Palette verfügbarer Assembly-Technologien prädestinieren den Fineplacer[®] matrix ma für den dreidimensionalen Aufbau hybrider Baugruppen (z.B. MEMS/MOEMS) und vielfältige C2W-Anwendungen.

Ob für Rework oder Bonding: dank seiner Vielseitigkeit bewältigt das System aktuelle und zukünftige technologische Herausforderungen und ist stets eine zukunftssichere Investition. Durch die modulare Systemarchitektur lässt es sich einfach um Prozessmodule erweitern und deckt als einziges Gerät im Markt ein derart breites Spektrum anspruchsvoller Anwendungen ab. Das effiziente Konzept Plug & Work sorgt zudem für schnelle Umrüstzeiten und ermöglicht einen einfachen Service-Zugriff.

Finetech GmbH & Co. KG, Wolfener Straße 32/34 Haus L,
D-12681 Berlin, www.finetech.de

Halle 6, Stand 406

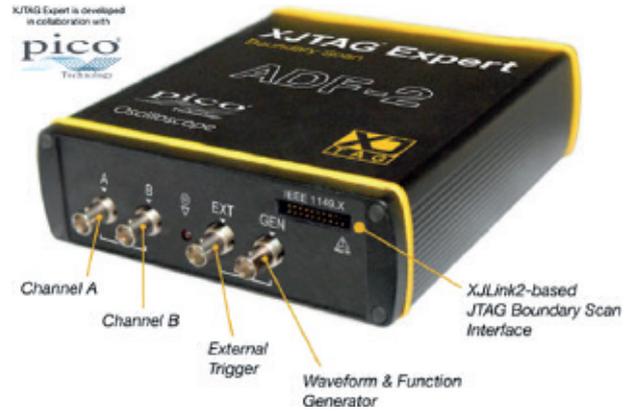


Scan-Testsystem mit integriertem digitalem Oszilloskop

Das weltweit erste Boundary Scan-Testsystem mit integriertem digitalem Oszilloskop, Funktionsgenerator und Protokoll Analyser wurde auf der Embedded World 2012 zeitgleich am Stand von XJTAG und

FlowCAD vorgestellt. Die Kombination dieser Funktionen in einem Gerät macht es zum idealen Hilfsmittel für Entwickler bei der Inbetriebnahme von elektronischen Geräten und ist ab sofort bei FlowCAD erhältlich.

Beim Bring-up eines Prototypen geht ein Entwickler schrittweise vor, indem er Teile der Schaltung nacheinander in Betrieb nimmt und deren Funktion nacheinander testet. Hierzu benötigt er neben einem Oszilloskop auch einen Funktions- oder Waveform-Generator, um nicht vorhandene Eingangssignale zu ersetzen. Sollten dann serielle Übertragungsprotokolle wie CAN Bus, I²C, SPI, RS232 und UART nicht die gewünschten Eigenschaften haben, können die Protokolle mit dem gleichen Gerät analysiert werden. Zur Untersuchung der Hardware wird immer häufiger das Boundary Scan-Verfahren verwendet, indem über die JTAG-Schnittstelle interne Verbindungschecks ausgeführt werden können und so ein Großteil der Netzliste geprüft werden kann. Zusätzlich lässt



sich über die Boundary Scan-Schnittstelle ein Code in programmierbare Bausteine laden. Was bisher nur mit verschiedensten Geräten möglich war, lässt sich mit dem ab April 2012 verfügbaren XJTAG Expert ADF-2 und einem Laptop an jedem Schreibtisch durchführen.

FlowCAD EDA-Software Vertriebs GmbH, Mozartstraße 2, D-85622 Feldkirchen bei München, www.FlowCAD.de

PCIM Halle 12, Stand 470

Drei gute Gründe für Ihren **Besuch...**

... auf der

smthybridpackaging

NÜRNBERG, 8. - 10. MAI



TCM45A
Selektiv Conformal
Coating
BLASENFREI!

NEU



Excen - NEW GENERATION
120.000 BT/h auf
kleinstem Raum

NEU



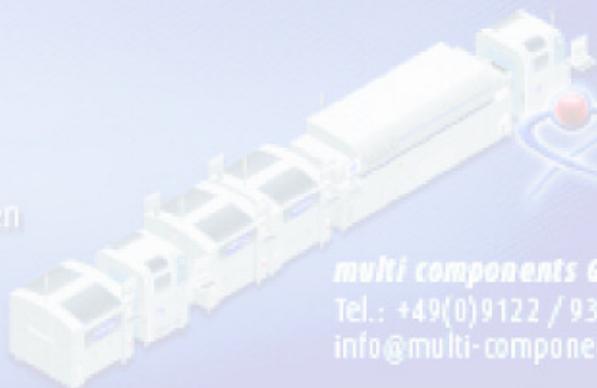
TR7 007 Serie II - NEW GENERATION
3D-Lotpasteninspektion
intuitive Bedienung über Touch Screen

NEU

Halle 7
Stand 320

Flexibel
auf der ganzen

Linie!



multi components
factory automation

multi components GmbH Roßtaler Str. 7 · 91126 Schwabach
Tel.: +49(0)9122 / 93 02-0 · Fax: +49(0)9122 / 93 02-90
info@multi-components.de · www.multi-components.de